

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Centrale d'électricité



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Fonctionne avec	Package Quantity	Profondeur	Largeur
---------------------	------	-----------------	------------------	------------	---------

24830-005	Heat Conductor	coffrets	1	22 mm	22 mm
-----------	----------------	----------	---	-------	-------

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE